

北京国化新材料技术研究院有限公司文件

关于召开“2026（第二届）亚洲有机硅技术交流会”的预通知

各有关单位：

当前全球有机硅产业正处于供需重构与价值重塑的关键转折期——中国产能占全球 70%以上，行业从无序竞争迈入协同自律新阶段，新能源汽车、光伏等新兴领域需求爆发式增长，海外产能收缩带来结构性机遇。

为搭建亚洲有机硅对话平台，破解产能平衡、技术升级、市场拓展等核心难题，在首届成功举办的基础上，我院联合硅产业绿色发展联盟等多家单位，拟定于 2026 年 4 月 13-15 日在中国苏州举办“2026（第二届）亚洲有机硅技术交流会”。本届盛会将以“智汇亚洲，硅见未来”为主题，分“亚洲各地有机硅宏观趋势”、“有机硅技术前沿与未来应用场景”两个主题，重点讨论亚洲各地有机硅宏观趋势、技术创新、加工工艺、先进设备，并探索其在医疗、汽车、电子、消费品等多个领域的新商业应用及趋势。

大会采用中英双语同声形式，预计将有来自亚洲各地区约 150 位有机硅行业精英及利益相关者共同探讨行业的“新趋势、新应用、新商机”，汇聚顶尖智慧，共同勾勒有机硅产业发展的未来图景。报名本会，可免费参加同期同地举办“2026 亚洲硅业科技大会及展览会 AST2026”系列活动及“2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会 ACMIE2026”系列活动，让您近距离与国际客商深入交流，准确了解

国际有机硅大势，有效把握行业商机。具体通知如下：

一、组织机构

支持单位：中国氟硅有机材料工业协会

中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会

硅产业绿色发展联盟 SAGSI

中关村光伏产业联盟 ZPVA

云南省硅工业工程研究中心

主办单位：北京国化新材料技术研究院

ACMI Europe GmbH.

承办单位：ACMI 硅材料发展中心

ACMI 硅基新材料研究所

支持媒体：有机硅、ACMI@Linkedin、气凝胶产业、ACMI 硅基新材料、ACMI 光伏新材料、国化新材料研究院、化工新材料、硅产业绿色发展联盟官网

二、暂定日程

（一）时间地点：

会议时间：2026 年 4 月 13-15 日

会议地点：江苏苏州

会议场地：苏州狮山国际会议中心

场地地址：江苏省苏州市虎丘区金山东路 78 号

（二）会议议程（中英双语）：

4 月 13 日全天	注册、签到及展览
4 月 14 日上午	“2026 亚洲硅业科技大会及展览会 AST2026” 主论坛

4 月 14 日下午	主题一：亚洲各地有机硅宏观趋势
4 月 15 日上午	主题二：有机硅技术前沿与未来应用场景
报名本会 免费参加	2026 亚洲硅业科技大会及展览会（AST2026） 1、2026（第二十八届）有机硅精细化学品技术交流会 2、2026（第三届）高纯石英材料技术及应用高峰论坛 3、2026（第二届）气凝胶制品新技术新应用交流会 4、2026 国际先进热管理材料技术交流会 5. 2026 国际化工新材料合作与出海峰会
	2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会（ACMIE2026）： 1. FMC2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会 2. 2026（第三届）液冷技术创新与市场应用论坛 3. 2026 半导体关键材料与应用技术交流会 4. 2026 钙钛矿电池技术与应用交流会 5. 2026（第十五届）环氧树脂高端应用技术交流会 6. 2026 有机胺及改性胺产业论坛 7. 烯·聚 2026 乙烯下游高端聚合物发展研讨会 8. 2026（第六届）丙烯酸酯及甲甲酯产业链发展论坛暨丙烯酸酯 高端应用交流会 9. 2026（第十二届）表面活性剂高端应用技术交流会 10. 特塑·热点 2026（第二届）特种工程塑料产业峰会 11. 2026 年辐射固化创新发展论坛 12. 2026 年电子胶技术与应用创新发展论坛
4 月 13-15 日 展览会	2026 亚洲硅业科技大会及展览会（AST2026） 2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会（ACMIE2026）

三、拟邀请参会人员

1. 有机硅行业专家、学者；
2. 有机硅代表性企业高层管理人员，
3. 亚洲有机硅上下游企业（原材料、有机硅单体、硅油、硅烷

偶联剂、硅橡胶、硅树脂、下游制品、设备等）负责人、技术与研发人员、市场与销售人员；

4. 新能源汽车、光伏、电子、电力、医疗、建筑等终端应用领域采购及研发人员

5. 有机硅行业协会、学会、科研院所代表；

6. 投资机构、咨询机构分析师；

7. 国内外有机硅产业商贸代理商、海外采购商

四、收费标准

（一）参会费用

2026 年 3 月 15 日前汇款 700 美元/人， 2026 年 3 月 15 日后汇款及现场缴费 800 美元/人。中国境内按照实时汇率折算人民币。

账户一(汇款注明：ASTEC2026)

Intermediary Banker's Name: JPMORGAN Chase Bank, ASSOCIATION, New York CITY, NEW YORK

SWIFT Code: CHASUS33

Bene Banker's A/C No.: 001043718

Beneficiary Banker's Name: Industrial and Commercial Bank of China, Beijing Zhonghangyou sub-Branch

BANK Address: FIRST FLOOR, BUILDING 9, 5 ANDING ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

SWIFT Code: ICBKCNBJBJM

Beneficiary: Beijing Sino Advanced Chemical Materials Institution Co., Ltd.

0200 2282 0902 0125 456

Address: Rm.1510, Building 4, Yard 18, Kechuang 13th St., Economic & Technological Development Zone, Beijing, China

账户二(汇款注明：ASTEC2026)：

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456

（二）商务合作

会议接受赞助发言、展位、会刊广告、挂绳、胸卡、易拉宝对接等各类商务合作，详询会务组。

五、联系方式

熊 爽/Sharon Hsiung +86-13811366249 xiongshuang@acmi.org.cn

梁雅婷/Grace Liang +86-18086626501 liangyating@acmi.org.cn

唐乃美/Nicole Tang +86-18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn

附件 1：参会回执表

附件 2：分论坛及暂定议题

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二五年十二月三日



附件 1:

参 会 回 执 表

会议名称	2026（第二届）亚洲有机硅技术交流会			
企业* (发票抬头)				
经营产品	(限添 3 种, 将录入通讯录中)			
通讯地址*				邮 编
参会代表	姓 名	职 务	手 机	电子邮箱
详细信息*				
参会费用	会议简称:		3 月 15 日前	3 月 15 日后及现场
	ASTEC2026		700 美元/人	800 美元/人
	____万 ____仟 ____佰 ____拾 ____元 ¥: ____元 (含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: ASTEC2026)			
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款注明: ASTEC2026			
住宿信息*	杭州滨江开元名都大酒店 地址: 浙江省杭州市滨江区火炬大道岩大房巷 59 号 电话: 0571-56971666			
	豪华大床 380 元/天(含早) ____间; 豪华双床 380 元/天(含早) ____间; 填数字 0、1 或 2 或 3 (签到时间 月 日, 会议时间 月 日) 住宿时间: ____月 ____日至 ____月 ____日 共 ____天 (因本次会议人数较多, 房间有限, 未提前支付会议费的, 住宿请自行安排。会务组仅负责提前 预留房间, 房费与酒店直接结算, 预留房间截止日期 2025 年 4 月 15 日)			
会务组	熊 爽/Sharon Hsiung +86-13811366249 xiongshuang@acmi.org.cn 梁雅婷/Grace Liang +86-18086626501 liangyating@acmi.org.cn 唐乃美/Nicole Tang +86-18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn			
提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组(以上一人即可), 以便制作通讯录等资料; 发票种类(打√): 电子专票 ____; 电子普票 ____。 开票资料:				

附件 2：分论坛及暂定议题

主题一、亚洲各地有机硅宏观趋势

1. 地缘政治重构下的全球有机硅供应链：韧性、区域化与未来格局

内容方向：分析全球贸易格局变化对供应链的影响，探讨企业如何构建更具韧性的供应链体系，以及未来十年全球产能布局的趋势。

2. 有机硅产业的碳中和路径与绿色金融机遇

内容方向：深入探讨从原材料、生产到回收的全生命周期碳足迹管理，分享领先企业的净零排放战略，并解析如何利用绿色金融工具赋能转型。

3. 亚洲有机硅市场格局重塑：产能、贸易与竞争态势分析

内容方向：深入解读中国、东南亚、印度、日韩等主要国家与地区的产能布局、进出口数据及未来竞争格局变化。

4. 下一个十亿级市场：新兴经济体的崛起与有机硅需求爆发点预测

内容方向：聚焦印度、东南亚、中东等地区，分析其工业化、城市化进程中对有机硅在建筑、汽车、电子等领域带来的巨大增长潜力。

5. 变废为宝：有机硅化学回收技术的最新突破与经济性分析

内容方向：介绍将交联固化的有机硅废料重新转化为有价值单体或中间体的前沿化学工艺，并探讨其规模化生产的经济可行性。

主题二、 有机硅技术前沿与未来应用场景

1. 高性能有机硅新材料前沿

内容：聚焦导热硅脂、液态硅胶、自修复硅橡胶、高折射率光学硅胶等在高科技领域的最新研发成果。

2. 有机硅绿色工艺与智能制造

内容：探讨有机硅生产过程中的节能减排技术、催化工艺优化、副产物综合利用，以及工业 4.0 在智能化工厂中的应用。

3. 下一代有机硅应用技术突破

内容：专题讨论在新能源汽车（电池包密封、高压线缆绝缘）、医疗健康（植入级器械、3D 打印组织模型）、智能穿戴（柔性传感器）等领域的技术瓶颈与解决方案。

4. 超越传统：智能响应型有机硅材料（自修复、形状记忆、传感）的开发与应用愿景

内容方向：展示能在热、光、电、pH 值等刺激下改变性能的“智能”有机硅，及其在软体机器人、自适应穿戴设备、先进医疗器件中的革命性应用。

5. 有机硅在先进封装、热管理及芯片散热中的核心作用

内容方向：随着 AI 算力飙升，探讨高性能有机硅凝胶、导热界面材料、液态导热垫等在保护与冷却高性能芯片中的不可替代性。

6. 有机硅如何赋能电动汽车的 800V 平台、固态电池与自动驾驶传感器

内容方向：超越传统密封，聚焦高压绝缘材料、电池包导热灌封胶、LiDAR 传感器光学封装等在新一代电动汽车中的关键技术应用。

7. 绿色能源的“粘合剂”：有机硅在光伏、氢能及储能系统中的应用深化

与创新

内容方向： 分析新一代光伏组件用导电胶、水解稳定型密封胶，以及在电解槽、燃料电池和长时储能系统中的关键材料需求与解决方案。

8. 可调控力学性能的有机硅 3D 打印及其在软组织仿生中的应用

内容方向： 深入讲解如何通过材料配方和打印工艺的协同创新，打印出从软组织到软骨等不同模量的有机硅结构，及其在手术规划模型、仿生组织器官模型和个性化植入物中的具体应用。